

PLUS FIRMENVERZEICHNIS

Anmeldeformular

Eugen G. Leuze Verlag KG
Karlstraße 4

D-88348 Bad Saulgau

www.leuze-verlag.de

Das **PLUS-FIRMENVERZEICHNIS** erscheint in jeder Ausgabe der PLUS.

Durch die klare Gliederung findet der Leser schnell Ihre Firmenadresse unter den von Ihnen angegebenen Rubriken.

Füllen Sie bitte dieses Formular aus, kopieren Sie die nächste Seite, kreuzen Ihre gewünschten Rubriken an und senden beide Seiten an:

Eugen G. Leuze Verlag KG, per

Fax +49 7581 4801-10

oder per Post an obige Adresse.

Ihr Eintrag bietet in

übersichtlichen Rubriken
direkten Zugriff
auf die Lieferanten und
auf mögliche Kunden

rund um die Elektronische Baugruppe.

Ihr Eintrag:

LOGO

Ihr Signet beim
Adresseintrag –
für mehr Auf-
merksamkeit und
Wiedererkennung.

Firmenname: _____

Straße: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Telefon: _____ Fax: _____

E-Mail: _____

Internet: _____

Ansprechpartner: Klaus Decker, Tel. 07581 4801-27, E-Mail: klaus.decker@leuze-verlag.de

Konditionen: Der Auftrag gilt zunächst für 1 Jahr und läuft bis auf Widerruf. Die Vertragskündigung ist nur schriftlich jeweils 6 Wochen vor Jahresende möglich. Verspätet eingegangene Kündigungen können erst zum darauffolgenden Jahresende berücksichtigt werden. Der Grundpreis beträgt 320,- € Netto pro Jahr und beinhaltet

den Eintrag in bis zu 3 Rubriken. Jede weitere Rubrik kostet zusätzlich 96,- € pro Jahr. Die Abrechnung erfolgt aus buchungstechnischen Gründen kalenderjährlich im Voraus. Redaktionsschluss für Änderungen ist jeweils der 15. des Vormonats vor dem Erscheinungstermin. Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer.

Hiermit erteilen wir den **Auftrag** zur Eintragung in das **PLUS-FIRMENVERZEICHNIS**

- | | | |
|---|---|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Grundpreis (Eintrag in bis zu 3 Rubriken) | = | 320,- € |
| <input type="checkbox"/> Logo 1-Farbig beim Adresseintrag (Falls gewünscht, bitte ankreuzen) | = | 98,- € |
| <input type="checkbox"/> Ich bestelle noch zusätzlich _____ Rubrik/en à 96,- € pro Jahr | = | _____, - € |
| Gesamt Netto (zzgl. MwSt.): | | _____, - € |

Firmenstempel

Datum

Unterschrift

Rubriken

(1–3 Rubriken kosten 320,- € pro Jahr, jede weitere jeweils 96,- €)

Kreuzen Sie hier Ihre Rubriken an!!

1. Design

- Design-Dienstleister
- EDA Soft- u. Hardware
- Scannen u. Digitalisieren

2. Leiterplattentechnik

2.1 Hersteller

- Durchkontaktierte Leiterplatten/Multilayer
- HDI-Leiterplatten
- HF-Leiterplatten
- Leiterplattenhandel
- Nichtdurchkontaktierte Leiterplatten
- Prototypen und Muster
- Starrflexible und flexible Leiterplatten

2.2 Dienstleister

- Analysen
- Beratungsunternehmen
- Bohren/Ritzen, Laserbohren
- CAM/Plotten
- Elektrischer Test
- Laserbearbeitung Flex-Leiterplatten
- Lohngalvanik, Endoberfläche
- Oberflächenbehandlung
- Plotten
- Prüfadapter Hersteller

2.3 Zulieferer

- Basismaterial für HF- und MW-Technik
- Basismaterial und Dielektrika, Kupferfolien
- Bohr- und Fräswerkzeuge
- Chemie für die Innenlagenoxidation
- Chemie für Durchkontaktierung und Leiterbilddaufbau
- Chemie für Wasser- und Abwasserbehandlung
- Chemische Reiniger
- Entwickler-, Ätz- und Strippmedien
- Flexibles Basismaterial
- Galvano- u. Ätzresiste
- Hilfsmaterialien für Bohren/Fräsen und Verpressen
- Lötstopppress- und Hole Plugging

- Materialien für das Wärmemanagement
- Medien für die Endoberfläche
- Photo- und Presswerkzeuge

2.4 Maschinen u. Anlagen

- Absauganlagen für feste und gasförmige Stoffe
- Anlagenservice / Wartung
- Anlagen zur Wasser- aufbereitung und Abwassertechnik
- AOI- und AXI-Geräte
- Applikation des Lötstopplacks, Beschichtungslinien
- Belichter
- Bohr- & Fräsmaschinen, Ritzmaschinen
- Bond- und Nietsysteme zur Registrierung
- Bürsten, Entgraten
- DES-Anlagen
- Direktbelichter
- Durchkontaktierung und Leiterbilddaufbau
- Elektrischer Test
- Filtergeräte und -medien
- Gebrauchsmaschinen
- Innenlagenoxidation
- Kennzeichnung
- Kunststoffverarbeitung
- Laminatoren
- Laserbohrmaschinen
- Layupsysteme f. Multilayer
- Leiterplattenreparatur
- Multilayer-Pressen
- Messmaschinen/Scanner
- Oberflächenbehandlung
- Photoplotter
- Plasmabehandlung
- Pluggingmaschinen
- Pressblechreinigung/ Aufarbeitungsservice
- Pumpen
- Recycling von Materialien
- Reinigungsanlagen/-systeme
- Selektive Metallabscheidung
- Siebdruckanlagen
- Stromversorgungen
- Transport- und Handlingsgeräte
- Trocknungsanlagen

2.5 Software

- Impedanzberechnung
- Konstruktion und Dokumentation des Leiterplatten-/Multilayer-Aufbaus

3. Baugruppenteknik

3.1 Dienstleister

- Beratungsfirmen
- Bestückung
- BGA-Rework
- Coating
- Drahtbonden
- Eingabesysteme aus Glas
- Geräteentwicklung
- Gerätemontage
- Kabelkonfektionierung
- Komplettservice
- Prototypen
- Qualitäts- und Prozesskontrollen
- Reinigungsprozess
- Reparatur- und Reballingschablonen
- Schablonen-Spannsysteme
- SMD-Schablonen
- Substratintegration
- Test/Prüfung
- Unterfüllung
- Vereinzeln von Flex-Schaltungen
- Verguss

3.2 Bauteile- und Werkzeuglieferanten

- Druck-Unterstützungswerkzeuge
- Lötmasken / Warenträger
- Steckverbinder und Fassungen/elektromechanische Komponenten
- Testadapter

3.3 Materialzulieferer

- Gießharze, Vergussmassen, Unterfüller- und Glob Top-Materialien
- Klebstoffe, SMD-/Chip-Kleber, elektrisch und thermisch leitfähige Klebstoffe, Wärmeleitpasten
- Lote, Lotpasten, Flussmittel, Lötformteile
- Reinigungsmedien und -materialien
- Schutzlacke

3.4 Maschinen u. Anlagen

- AOI, AXI und Mikroskope
- Aushärte-/Trockenöfen
- Bestückungsgeräte und -automaten
- Dispenser / Dosiergeräte
- ESD-Schutzeinrichtungen und -zubehör
- Gebrauchsmaschinen
- Incircuit / Funktionstester
- Kennzeichnungs- und Identifikationsgeräte

- Lötanlagen und -geräte
- Lotpasteninspektion
- Pastendrucker
- Reinigungsanlagen/-systeme
- Schutzbeschichtungsanlagen
- Temperaturprofiler
- Transport- und Handlingsgeräte

3.5 Software

- Fertigungssoftware
- Traceability / MES

4. Packaging / Hybridtechnik

4.1 Hersteller

- 3D-MID
- Chipgehäuse und Module
- Dickfilmschaltungen
- Hermetisch dichte Sockel/Gehäuse
- Mehrlagenkeramikschaltungen

4.2 Zulieferer

- Bonddraht
- Dickfilmpasten
- Drucksiebe
- Keramiksubstrate

4.3 Maschinen u. Anlagen

- Aushärteanlagen
- Ball Placement Masch.
- Die- und Chipmontagegeräte und -systeme
- Dispenser / Dosiergeräte
- Drahtbonden
- Gebrauchsmaschinen
- Nasschemische Anlagen für stromlose Ni/Au Metallisierung
- Prüfgeräte
- Reinraumeinrichtungen und -zubehör
- Sieb- und Schablonendruckgeräte
- Trimmklaser
- Trocken- / Einbrennöfen

4.4 Dienstleister

- Einbetttechnik
- Wafer Bumping

5. Zuverlässigkeit

- Qualifizierung
- Zuverlässigkeitsuntersuchungen

6. Sonstiges

- Logistik